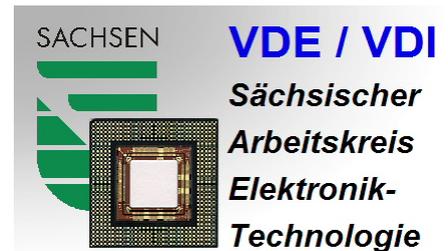


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
01069 Dresden
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann
Technische Universität Dresden
Zentrum für mikrotechnische Produktion
01062 Dresden
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



Informationen zum Arbeitskreis im Internet:

<http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

40. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Thema: *FNE- Rehm-Symposium „Bleifreie Löttechnologie“*

Gastgeber: FNE Forschungsinstitut für Nichteisen-Metalle Freiberg GmbH und
rehm Anlagenbau Blaubeuren GmbH

Ort: FNE Forschungsinstitut für Nichteisen-Metalle Freiberg GmbH
Lessingstraße 41, 09599 Freiberg

Datum: 05. Mai 2004 10:00 Uhr

Agenda:

- 10:00 Uhr Begrüßung
Herr Pachschwöll – FNE, Herr Preußner – rehm
- 10:20 Uhr Entwicklung bleifreier Lotpasten
Herr Härtel – FNE
- 11:00 Uhr Bleifrei metallisierte Leiterplatten
Herr Dr. Bechtloff – KSG
- 11:40 Uhr Röntgeninspektion elektronischer Baugruppen
Herr Dr. Becker – phoenix|x-ray
- 12:20 Uhr *Mittagsimbiss*
- 13:20 Uhr Reflowtechnologie für bleifreies Löten
Herr Dr. Bell – rehm
- 14:00 Uhr Zuverlässigkeit bleifreier Lötverbindungen
Herr Dr. Berek – FNE
- 14:40 Uhr *Kaffeepause*
- 15:00 Uhr Aktuelle Maschinenentwicklungen rehm
Herr Dr. Bell – rehm
- 15:20 Uhr Aktuelle Entwicklung FNE
Herr Dr. Marx - FNE
- 15:40 Uhr Informationen aus dem Sächsischen Arbeitskreis Elektronik-Technologie
Herr Prof.Dr. Bauer – HTW Dresden
- 16:00 Uhr Diskussion
- 16:30 Uhr *Ende der Veranstaltung*

Alle Interessenten sind herzlich zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei der Firma FNE (Herr Dr. Beyer: beyer@fne-freiberg.de) an!